

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,088,544.93	924,925.23	17.69
营业利润	46,364.68	48,196.47	-3.80
利润总额	46,698.64	48,245.94	-3.21
净利润	46,679.03	48,219.63	-3.19
归属于母公司所有者的净利润	69,622.44	53,284.06	30.66
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	19,405.81	39,436.68	-50.79
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,031.28	3,110.11	672.68
基本每股收益（元）	0.36	0.27	33.33
加权平均净资产收益率	3.27%	2.52%	增长 0.75 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	5,329,826.12	5,039,857.94	5.75
归属于母公司的所有者权益	2,176,050.66	2,087,031.10	4.27
股本	200,759.17	200,613.52	0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.94	10.74	1.86
流动资产	754,472.47	974,386.65	-22.57
非流动资产	4,575,353.65	4,065,471.30	12.54
流动负债	526,143.23	742,576.55	-29.15
非流动负债	1,994,884.82	1,688,384.65	18.15

其他综合收益	30,328.97	6,297.68	381.59
--------	-----------	----------	--------

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入 1,088,544.93 万元，较上年同期增长 17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 69,622.44 万元，较上年同期增长 30.66%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,405.81 万元，较上年同期下降 50.79%。

报告期末，公司总资产 5,329,826.12 万元，较本报告期初增长 5.75%；归属于母公司的所有者权益 2,176,050.66 万元，较本报告期初增长 4.27%；归属于母公司所有者的每股净资产 10.94 元，较本报告期初增长 1.86%。

报告期内，影响经营业绩的主要因素：（1）半导体行业景气度回升带动 CIS、PMIC 及 DDIC 等主要产品的市场需求进一步扩大，公司凭借优质可靠的代工方案持续获得客户认可，订单规模稳步增加；（2）公司整体产能利用率维持在高位，规模效应持续显现，综合毛利率预计为 25.52%；（3）公司结合市场动态、客户需求及自身发展战略，持续进行产能扩充、拓展产品应用领域及开发高阶工艺平台，相关研发费用及固定资产折旧不断增加，对当期经营业绩造成一定影响。与此同时，公司通过实现 150nm 至 40nm 主流技术节点的规模化量产，并在巩固现有产品的情况下积极推动技术研发，进一步增强了公司产品竞争力和业务多元化水平。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长 30.66% 和 33.33%，主要系报告期公司产品销量增加，收入规模持续增长，及本报告期公司转让光罩相关技术所致。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 50.79%，主要系：①公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加；②受利息收入减少及汇兑损失增加影响，财务费用较上年同期增加；③受资产转固及股权激励影响导致管理成本增加。

报告期末其他综合收益较上年末增长 381.59%，报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增长 672.68%，主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

三、风险提示

本公告所载的 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2025 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日